

Lotpasten zum Dosieren
Pâte à braser pour dosage et jet printing

5 ccm
Kartusche / cartouche



- ~ 14,3 mm Durchmesser
Diamètre
- ~ 68,3 mm Länge
Longueur
- ~ 25 g Inhalt bleihaltig
Poids net au plomb
- ~ 20 g Inhalt bleifrei
Poids net sans plomb

10 ccm
Kartusche / cartouche



- ~ 19,1 mm Durchmesser
Diamètre
- ~ 88,9 mm Länge
Longueur
- ~ 40 g Inhalt bleihaltig
Poids net au plomb
- ~ 40 g Inhalt bleifrei
Poids net sans plomb

30 ccm
Kartusche / cartouche



- ~ 25,4 mm Durchmesser
Diamètre
- ~ 115,9 mm Länge
Longueur
- ~ 80 ~ 100 g Inhalt bleihaltig
Poids net au plomb
- ~ 80 ~ 100 g Inhalt bleifrei
Poids net sans plomb

100 ccm
Kartusche / cartouche



- ~ 35,8 mm Durchmesser
Diamètre
- ~ 191,0 mm Länge
Longueur
- ~ 250 g Inhalt bleihaltig
Poids net au plomb
- ~ 250 g Inhalt bleifrei
Poids net sans plomb

30 ccm
Kartusche / cartouche



- ~ 26,4 mm Durchmesser
Diamètre
- ~ 130 mm Länge
Longueur
- ~ 100 g Inhalt bleihaltig
Poids net au plomb
- ~ 100 g Inhalt bleifrei
Poids net sans plomb

Alle Lotpasten in Kartuschen

- ▶ für manuelles oder automatisches Dosieren
- ▶ mechanisch oder mit Druckluft
- ▶ mit Luer-lock Anschluss
- ▶ auch für sehr feine Nadeln geeignet
- ▶ konstante Verarbeitbarkeit

Pâte à braser en cartouches

- ▶ pour un dosage manuel ou automatique, mécanique ou à air comprimé avec connexion Luer-Lock
- ▶ Adapté même aux petites aiguilles
- ▶ Conditions de process constantes

Bleihaltige Lotpasten im Überblick
Les pâtes à braser au plomb

Flussmittel Flux	Legierung Alliage	Zusammensetzung Composition	Schmelzbereich Température de fusion	besonderer Vorteil Caractéristiques
HM 1-RMA ROL1	Sn 62	Sn-2.0Ag-36Pb	179 – 190°C	hervorragende Druckeigenschaften <i>très bon transfert en sérigraphie</i>
HM 1-RMA T3 ROL1				lange Standzeit auf der Schablone <i>longue durée de vie sur écran</i>
HA 2-RA ROM1				einfach zu reinigen <i>nettoyage simple</i>
SSHA-S ROM1				hervorragende Fließeigenschaften <i>excellente fluidité</i>
HM 1-RMA T3 ROL1	Sn 62.8	Sn-0.4Ag-36.8Pb	178 – 183°C	lange Standzeit auf der Schablone <i>longue durée de vie sur écran</i>
HM 1-RMA ROL1	Sn 63	Sn-37Pb	183°C	hervorragende Druckeigenschaften <i>très bon transfert en sérigraphie</i>
HA 2-RA ROM1				einfach zu reinigen <i>nettoyage simple</i>
SSHA-SJS ROM1				niedrige Temperatur, hohe Festigkeit <i>point du fusion bas, haute résistance</i>
HM 1-RMA ROL1	SJ-7	Sn-3.0Ag-0.5Sb-34.5Pb	179 – 187°C	hervorragende Druckeigenschaften <i>très bon transfert en sérigraphie</i>
HA 2-RA ROM1				einfach zu reinigen <i>nettoyage simple</i>
SSHA-S ROM1				hervorragende Fließeigenschaften <i>excellente capacité de rayonnement</i>
SSHA ROM1	SJS	Sn-1.5Ag-0.5Sb-38Pb	171 – 181°C	niedrige Temperatur, hohe Festigkeit <i>point du fusion bas, haute résistance</i>
HM 1-RMA ROL1	SJ-3 Bi	Sn-1.5Ag-0.5Sb-3.0Bi-38Pb	171 – 181°C	hervorragende Druckeigenschaften <i>très bon transfert en sérigraphie</i>
HA 2-R ROM1				einfach zu reinigen <i>nettoyage simple</i>

Alle unsere bleihaltigen Pasten sind mit folgenden Korngrößen erhältlich / Toutes nos pâtes à braser au plomb sont disponibles dans les tailles de poudre suivantes: V14L (Type 3) 25-45µm und/et V16L (Type 4) 20-38µm
Alle unsere bleihaltigen Pasten sind mit den folgenden Flussmittelanteilen verfügbar / Toutes nos pâtes à braser au plomb sont disponibles avec le contenu de flux suivant 9,5% und/et 10,0%



Votre Distributeur en France

CEPELEC
14 rue des Platanes
38120 Saint-Egreve
Tel.: +33 (0) 4 76 49 00 37
cepelec@cepelec.com
www.cepelec.com

Almit GmbH
Unterer Hammer 3
DE-64720 Michelstadt

Tel.: +49 6061 96925-0
Fax: +49 6061 96925-18

info@almit.de
www.almit.de



Lotpasten
Pâtes à braser

Legierungen und Flussmittel
Alliages et flux



Von der perfekten Paste für flexible Träger bis zur optimalen Langzeitzuverlässigkeit – für jede Anforderung die richtige Lösung.

De la pâte à braser idéale pour les circuits imprimés flexibles, à la fiabilité optimale à long terme - pour chaque besoin, la solution parfaite

Flussmittel der bleifreien Lotpasten
Flux des pâtes à braser sans plomb

Flussmittel Flux	Klassifizierung Classification du flux	besonderer Vorteil Caractéristiques
NH (LVA) 100% halogenfrei / sans halogène	Neu Nouveau	ROL0
weniger Lunker, bessere Druckbarkeit <i>réduit les void; très bon transfert en sérigraphie</i>		
MR-NH	Neu Nouveau	ROL0
geeignet sogar für Anwendungen mit einer area ratio kleiner 0,6 <i>convient également pour les applications avec un ratio d'ouverture du pochoir inférieur à 0,6</i>		
NH(-MDL) 100% halogenfrei / sans halogène		ROL0
Laser-/Induktionslöten / <i>micro dosage</i>		
NH (IMT) 100% halogenfrei / sans halogène		ROL0
verhält sich wie L1 Paste, perfekt auch nach langer Standzeit <i>caractéristiques idem pâte L1, reste parfaite même après une longue période d'ouverture</i>		
NH-JLB		ROL0
Auch für Wismut-Lot zum Jeten <i>également pour un alliage au bismuth dépôt jet printing</i>		
G40 N2 empfohlen / N2 recommandé		ROL0
acryl-basiertes viscoelastisches Flussmittel <i>flux viscoélastique à base d'acrylique</i>		
G40 A N2 empfohlen / N2 recommandé		ROL1
acryl-basiertes viscoelastisches Flussmittel <i>flux viscoélastique à base d'acrylique</i>		
SNTP		ROL1
Lotpaste für Package-on-Package (POP) <i>pâte à braser pour technologie POP (Package On Package)</i>		
FS für Korngröße (N) / pour taille de grain (N)		ROL1
Bauteilgröße 01005 <i>pour pas très fin et composants type 01005</i>		
SPT für Korngröße (G) / pour poudre de taille (G)		ROL1
Lotpaste Korngröße 6 <i>pour poudre de classe 6</i>		
INP		ROL1
für indium-basierende Legierungen entwickelt <i>conçu pour les alliages à base d'indium</i>		
MHS-32		ROL1
entwickelt für Zinn-Zink Legierungen <i>conçu pour les alliages étain-zinc</i>		
GT-Serie		ROL1
hohe Vorheiztemperatur, perfektes Druckbild <i>température de préchauffage élevée, forme d'impression parfaite</i>		
SUC-Serie		ROL1
O ₂ Reflow, wenig Lunker / <i>refusion sous azote faible taux de void</i>		
PZV		ROL1
ideal für niedrige Peak-Temperaturen <i>parfait pour les pics de refusion basse température</i>		
H-FA		ROL0
Laserlöten / <i>applications brasage laser</i>		
MDA-5		ROL1
Jet-Paste für MYDATA U <i>pâte à braser applications jetting pour machine MYDATA U</i>		
MJD		ROL1
Jet-Paste für Musashi R5-20 <i>pâte à braser applications jetting pour machine Musashi R5-20</i>		
SSI-M		ROM1
Laserlöten / <i>applications brasage laser</i>		
TM-HP (O)		ROM1
lange Offenzeit / <i>longue durée de conservation</i>		
SBR		ROL1
ideal für Wismutlegierungen / <i>idéal pour les alliages au bismuth Toutes nos</i>		

Legierungsübersicht für bleifreie Lotpasten
Les pâtes à braser sans plomb

Legierung Alliage	Zusammensetzung Composition	Schmelzbereich Température de fusion	besonderer Vorteil Caractéristiques
LFM-65	Sn-58.0Bi	139°C	sehr niedriger Schmelzbereich, Sn-Bi eutektisch <i>alliage Sn-Bi eutectique à très basse fusion</i>
LFM-89	Sn-57.6Bi-0.4Ag	139 – 168°C	niedrig schmelzende Wismutlegierungen mit erhöhter Festigkeit <i>alliages de bismuth à très basse fusion avec forte résistance</i>
LFM-78	Sn-57.0Bi-1.0Ag	139 – 179°C	niedrig schmelzende Wismutlegierungen mit erhöhter Festigkeit <i>alliages de bismuth à très basse fusion avec forte résistance</i>
LFM-31	Sn-8.0Zn-3.0Bi	190 – 203°C	verwendbar auch mit dem Lötprofil von Sn-Pb Legierungen / <i>également utilisable avec profil de température en alliage Sn-Pb</i>
LFM-70	Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In	194 – 206°C	niedriger Schmelzbereich, SABI <i>température de fusion basse, SABI</i>
LFM-96	Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In	202 – 210°C	niedriger Schmelzbereich, SABI <i>température de fusion basse, SABI</i>
SJM-03	Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-a	210 – 225°C	niedriger Silberanteil, hohe Lötstellenfestigkeit <i>résistance élevée des joints</i>
LFM-90	Sn-1.0Ag-0.7Cu	217 – 224°C	JEITA empfohlen <i>recommandation JEITA</i>
SJM-35	Sn-3.5Ag-2.0Bi	216 – 220°C	hoher Silberanteil, hohe Lötstellenfestigkeit <i>résistance élevée des joints</i>
SJM-30	Sn-3.0Ag-2.0Bi-1.0Sb	216 – 224°C	hohe Lötstellenfestigkeit <i>résistance élevée des joints</i>
LFM-48	Sn-3.0Ag-0.5Cu	217 – 220°C	SAC, JEITA empfohlen <i>SAC, recommandation JEITA</i>
LFM-73	Sn-1.0Ag-0.5Cu	217 – 226°C	niedriger Silberanteil, SAC <i>SAC avec faible teneur Ag</i>
LFM-86	Sn-0.3Ag-0.7Cu	217 – 228°C	niedriger Silberanteil, SAC <i>SAC avec faible teneur Ag</i>
LFM-34	Sn-3.5Ag	221°C	Sn-Ag <i>eutektisch / eutectique</i>
SJM-40*	Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-a	221 – 227°C	hoher Silberanteil, sehr hohe Lötstellenfestigkeit <i>très haute résistance des joints</i>
LFM-57	Sn-5.0Sb	235 – 240°C	hoher Schmelzbereich <i>température de fusion élevée</i>
LFM-74	Sn-10.0Sb	246 – 258°C	hoher Schmelzbereich, Sn-Sb <i>température de fusion élevée, Sn-Sb</i>

Korngrößen / Taille des billes / taille de poudre: X, W, U, N ;
Alle unsere bleifreien Pasten sind mit den folgenden Flussmittelanteilen verfügbar /
Toutes nos pâtes à braser sans plomb sont disponibles avec le contenu de flux suivant: 11–14%
*SJM-40 ist patentiert unter / est breveté sous: JP PAT Nr. 3045453 SJM = „Strong Joint Metal“ LFM = „Lead Free Metal“

Bevorzugte Produktkombinationen für Almit Lotpasten
Combinaison pour les pâtes à braser Almit

Legierung Alliage	Klassifizierung Classification du flux	Laserlöten & Induktion Brasage laser et à induction	Reflow-Löten (SMT) Brasage à refusion (SMT)
LFM-48 (SAC 305)	L0	HF-A	MR-NH
	L1	–	GT-Series
	M1	SSI-M	TM-HP(O)
SJM-Series (Sn, Ag, Cu, Bi)	L0	HF-A	NH(IMT)
	L1	–	GT-Series
	M1	SSI-M	TM-HP(O)
LFM-96	L1	–	INP

Korngröße Taille de la poudre	Partikeldurchmesser (µm) nach IPC / Diamètre des billes (µm) selon l'IPC			
	10% max. moins que	80% min.entre	10% max. entre	moins de 0,5% plus large que
3	25	25 – 45	45 – 60	60
4	20	20 – 38	38 – 50	50
5	15	15 – 25	25 – 40	40
6	5	5 – 15	15	25
7	2	2 – 11	11	15

Almit Korngrößen nach J-STD 005 / taille des billes Almit selon la norme J-STD 005						
Almit Bezeichnung / Nom Almit	X	W	U	N	R	G
Partikeldurchmesser in µm / Taille des billes en µm	25-45	20-38	10-28	10-24	5-20	5-15
Korngröße / Classification de la poudre	3	4	5	5/6	5.5	6

